

中国国际金融股份有限公司
关于苏州盛科通信股份有限公司

2023 年度持续督导跟踪报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关规定对苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”、“公司”）进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与盛科通信签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	在本持续督导期间盛科通信未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	在本持续督导期间盛科通信及其相关当事人未出现违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解盛科通信业务情况，对盛科通信开展持续督导工作

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	在本持续督导期间，保荐机构督导盛科通信及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促盛科通信依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对盛科通信的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，盛科通信的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促盛科通信严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对盛科通信的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	盛科通信无控股股东、实际控制人，本持续督导期间，公司及其董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，盛科通信及其主要股东不存在未履行承诺的情况

序号	工作内容	持续督导情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，经保荐机构核查，盛科通信不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	在本持续督导期间，盛科通信未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	在本持续督导期间，盛科通信不存在该种情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）尚未盈利的风险

2023年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,953.08万元、-6,652.43万元。截至2023年12月31日，公司累计未弥补亏损为6,367.91万元。

虽然公司2023年度收入同比大幅增长，但受到研发投入较大且毛利率波动等因

素的影响，公司仍然未能实现盈利，且存在累计未弥补亏损。影响公司盈利状况的主要因素中，研发投入较大主要系公司作为硬科技企业，注重技术创新和研发积累，为实现战略目标，维持较高的研发投入强度，并且交换芯片产品具有开发及生命周期较长、下游应用导入上量较慢等特点，公司当前研发投入所对应的产出会存在一定时延。而毛利率波动则受到产品销售结构变动及部分型号芯片产品毛利率降低的共同影响，其中前者系 2023 年度毛利率相对较低的以太网交换芯片的收入占比有所提升，后者的主要原因为，受近年来国际政治经济形势及国际产业链格局变化等外部因素的影响，集成电路行业的供应链相对紧张，导致 2023 年度公司部分型号芯片产品的毛利率出现波动。

虽然公司尚未盈利，但公司凭借深厚的技术积累，在精准把握客户需求的基础上加大研发力度、优化产品性能，近年来陆续推出了能够满足市场普遍需求的新产品，随着客户认可度不断提升，公司与主要客户的合作持续加深，芯片销量快速增长。在市场的大量应用下，公司的产品与技术已经得到了验证，构建了稳定的下游应用生态，在国产厂商中保持领先地位，为未来进一步的成长奠定了坚实的基础。

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

2023 年度，公司实现营业收入 103,741.60 万元，较上年同期增长 35.17%，保持良好增长态势；公司归属于上市公司股东的净利润为-1,953.08 万元，较上年同期减少亏损 988.99 万元，亏损同比小幅收窄，公司整体经营态势向好。

随着公司市场影响力以及客户认可度的不断提升，下游客户对公司产品规格的丰富度以及产品性能提出了更高要求。公司亦希望抓住当下国产化趋势带来的发展机会，在公司研发团队、资金均支持的情况下，快速提升自身市场地位，因此公司将加快补齐现有产品线的产品规格并向上延伸开发性能更佳的产品。但随着研发投入的进一步提升，若未来产品的市场拓展不及预期，则会对公司盈利能力产生较大影响，导致扭亏为盈时点可能出现延缓，甚至出现亏损幅度进一步扩大的情形。

（三）核心竞争力风险

1、产品研发风险

随着下游市场对产品性能需求的不断提升，集成电路设计行业技术升级和产品

更新换代速度较快，尤其是公司所处的以太网交换芯片领域，设计难度较高，需要对网络和网络未来的演进有深刻的理解。公司需紧跟市场发展步伐，及时对现有产品及技术进行升级换代，以维持其市场地位。凭借对以太网交换芯片行业未来发展趋势的前瞻性把握，公司已投入应用于大规模数据中心的系列芯片研发。

虽然公司产品的研发已经过充分论证，目标市场需求明确，产品研发进度良好，但由于芯片产品研发难度较大、研发过程较长、投入资金较高，对公司的资金投入和研发人员配置提出了较大的挑战，因此研发进度与研发成果存在较大不确定性。未来若公司以太网交换芯片技术研发进度不及预期、落后于行业升级换代水平，或公司技术研发方向与市场发展趋势偏离，以至于无法顺利实现客户认证并量产，则公司前期高额研发投入可能无法收回，并将对整体经营业绩造成不利影响。

针对上述潜在风险，一方面，公司将加强对行业新技术、新需求的动态跟踪，加强对市场需求的研判能力；另一方面，公司积极参与各类行业标准组织，参与甚至主导相关新产品标准的制定，从而降低后续产品研发风险。

2、核心技术人员流失风险

核心技术人员是公司研发创新、保持竞争优势及未来持续发展的基础。公司自成立以来一直重视技术、产品研发和研发团队建设，通过多年的实践和积累，公司已经研发并储备了多项核心技术和自主知识产权，培养、积累了一批核心研发技术人员。目前国内集成电路设计行业蓬勃发展，关键核心技术人才缺口较大，行业内人员呈现频繁流动趋势。如果未来公司薪酬水平相较同行业竞争对手丧失优势或公司内部激励和晋升制度无法得到有效执行，则在技术和人才的激烈市场竞争中，公司可能出现核心技术人员流失情况，将对公司经营产生不利影响。

3、技术泄密风险

通过持续技术创新，公司研发技术处于行业内较高水平。自成立以来，公司就十分重视对核心技术的保密，及时将研发成果申请专利，并制定了严格完善的内控制度，保障核心技术的保密性。但存在由于核心技术人员流动、技术泄密，或专利保护措施不力等原因，导致公司核心技术流失的风险。如前述情况发生，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司的竞争力产生不利影响。

（四）经营风险

1、供应商集中度较高的风险

公司采用 Fabless 经营模式，专注于产品的研发、设计和销售环节，将晶圆制造及封装测试等生产环节外包予供应商进行。目前已量产的产品中，公司主要采取与芯片量产代工商对接的模式，将与晶圆厂、封测厂沟通协调的部分环节交由芯片量产代工商执行，从而使公司能够更为专注于芯片研发环节，提高供应链整体效率。但因为量产代工模式的存在，公司当前供应商的集中度较高。此外，基于行业特点，全球范围内符合公司技术及生产要求的晶圆制造及封装测试供应商数量较少，公司芯片量产代工商建立合作关系的晶圆制造厂和封测厂呈现较为集中的状态。若公司主要供应商业务经营发生不利变化、市场需求旺盛造成产能紧张或合作关系紧张，可能导致其不能及时足量出货，从而对公司生产经营产生不利影响。

2、客户集中度较高的风险

公司下游客户集中度较高，主要由于采取“直销+经销”的销售模式，经销模式下一名经销商会对应多名终端客户。此外，公司的主要客户还包含有大型央企集团，集团合并口径交易金额较大。公司不存在对单一客户严重依赖的情况。

未来公司将继续保持当前的经营模式，因此未来客户集中度仍然会保持较高水平。若公司主要客户在经营上出现较大风险，大幅降低对公司产品的采购量或者公司不能继续维持与主要客户的合作关系，公司的业绩可能会产生显著不利的变化。

3、国拨项目拨款无法获得足额拨付的风险

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计垫付的国拨项目投入余额为 2,373.50 万元。鉴于国拨项目的验收、审计及资金拨付由委托方主导，未来存在可能因项目未通过委托方验收而无法获得足额经费拨付，从而导致已投入资金转入费用并对公司经营业绩构成不利影响的风险。

（五）财务风险

1、经营业绩波动风险

报告期内，公司整体市场竞争力稳步提升，营业收入总体增长情况良好，由于

公司持续加大研发投入，依旧处于亏损状态。公司净利润的波动主要受营业收入金额变动、产品毛利率变动、研发费用金额变动等影响。若未来由于国际政治经济环境恶化、国内宏观经济形势恶化、行业政策变更、行业竞争加剧、技术迭代更新而公司未能及时推出符合市场需求的产品、公司研发投入较大的新品未能受到市场认可而大量出货、上游原材料涨价或供应紧张、下游市场需求波动、在手订单无法按期执行等情况导致公司主要产品供需发生不利变化，可能对公司业务开展产生不利影响，并导致公司收入及经营业绩下滑。

2、毛利率波动风险

公司主要产品毛利率主要受下游市场需求、产品售价、原材料及委外加工服务采购成本及公司技术水平等多种因素影响。近年来，随着国际政治经济形势变化、国际产业链格局变化等外部环境的影响，集成电路行业的供应链相对紧张，导致公司的原材料采购价格面临上涨压力。若未来公司无法及时推出高毛利新品、提升业务规模以增强对上下游议价能力从而化解上述压力，可能导致公司毛利率波动，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

3、存货跌价风险

公司存货主要为原材料、半成品、库存商品和发出商品，2023年末存货金额为71,625.61万元，较上年同期增长154.61%，占期末总资产比重为22.78%。公司期末存货金额持续增加，主要系随着销售规模的扩大、产品市场需求量的增加以及受全球半导体供应形势的影响导致上游产能供应的不确定性增加，公司为满足销售要求并及时响应客户需求而增加备货所致。公司高度关注存货的安全性，会结合市场需求情况定期对公司存货情况及产品预定情况进行分析，确保存货结构的合理性。公司亦定期根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，以确保公司财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或存货管理水平无法满足公司快速发展的需求，可能导致短期内公司存货周转速度快速下降，存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

4、预付款项减值风险

2023年末公司预付款项余额为40,431.38万元，较上年同期增长114.38%，占期

末总资产比重为 12.86%。近年来，受公司市场份额稳步提升及全球半导体行业供应形势的影响，下游客户对公司长期稳定的供应提出了更高要求，为确保其远期需求能够得到满足，下游客户会向公司支付部分预定产品的款项进而形成公司的合同负债。因此，公司为了保证客户侧的产品供应能力，在提升库存水平的同时，亦向上游芯片量产代工商预付晶圆生产款项提前预定相应产能，导致公司预付款项金额较大。未来，若相关预付款对手方因财务状况恶化、失信等因素违反业务合作约定或因国际宏观环境影响导致不能及时履行合同，将可能会导致公司预付款项存在减值风险，从而对公司经营状况、盈利水平造成不利影响。

（六）行业风险

1、行业周期波动的风险

公司是集成电路设计企业，属于集成电路行业的上游环节。集成电路设计行业具有技术密集型和资金密集型等特征，本身呈现一定周期性波动的特点。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势，将导致行业发生波动或需求减少，对公司经营情况造成一定的不利影响。

2、国家政策支持的风险

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，产业自主可控对国民经济和社会发展具有重要意义。近年来国家出台了一系列相关的鼓励政策推动了我国集成电路产业的发展，若未来国家相关产业政策支持力度显著减弱，公司的经营情况将会面临更多的挑战，可能对公司业绩产生不利影响。

（七）宏观环境风险

1、全球贸易摩擦风险

近年来，美国出台一系列半导体出口管制政策。2023 年 3 月 3 日，美国商务部工业与安全局将公司及子公司盛科科技列入美国《出口管制条例》“实体清单”中。根据《出口管制条例》规定，公司采购含有美国受限技术比例较高的“管制物品”将会受到限制。公司主要供应商包括芯片量产代工商、EDA 供应商、IP 供应商等，由于集成电路领域专业化分工程度及技术门槛较高，部分供应商提供的产品或服务具有稀缺性和专有性，公司更换新供应商会产生额外成本。

鉴于国际形势的持续变化和不可预测性，公司能否被移除出“实体清单”以及是否会受到来自于美国的进一步技术限制措施均存在不确定性。如果公司受到进一步的制裁措施，可能会进一步影响量产代工、EDA 供应商、IP 供应商对公司的产品生产或服务支持，对公司包括新产品研发、供应链保障等正常的生产经营活动造成较大不利影响。公司将持续关注相关规则的更新并积极做好应对措施。

2、宏观经济波动风险

公司的芯片产品主要定位中高端产品线，应用领域较为广泛，全面覆盖企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络等应用领域，自主研发的以太网交换芯片已进入新华三、锐捷网络、迈普技术等国内主流网络设备商的供应链，以公司芯片为核心生产的以太网交换设备已在国内主要运营商以及金融、政府、交通、能源等各大行业网络实现规模应用，因此公司业务发展不可避免会受宏观经济波动的影响。如果宏观经济形势不及预期或公司下游细分市场出现较大不利变化，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

3、汇率波动风险

公司存在部分境外采购及境外销售的情况，并主要通过美元进行相关采购和销售的结算。未来如果人民币与美元汇率发生大幅波动，可能导致公司产生较大的汇兑损益，引起公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。

4、税收优惠政策风险

公司于2018年10月24日通过高新技术企业认定(证书编码:GR201832001382), 并已通过高新技术企业复审, 取得高新技术企业证书(证书编码:GR202132010139), 公司企业所得税自2021年起3年内享受15%的企业所得税优惠税率, 因此公司在报告期的企业所得税按15%的税率计缴。根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第7号)的规定, 企业开展研发活动中实际发生的研发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按规定据实扣除的基础上, 自2023年1月1日起, 再按照实际发生额的100%在税前加计扣除; 形成无形资产的, 自2023年1月1日起, 按照无形资产成本的200%在税前摊销。根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转

年限的通知》(财税[2018]76号)规定,自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。如果未来国家对上述税收优惠政策作出调整,或公司不再满足享受上述税收优惠的条件,将对公司未来经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

(八) 无实际控制人风险

公司股权结构较为分散,根据公司的决策机制,任一股东及其一致行动人或最终权益持有人均不足以对公司的股东大会、董事会决策产生决定性影响力,因此公司无控股股东和实际控制人。未来可能存在因无实际控制人导致公司治理格局不稳定或决策效率降低进而贻误业务发展机遇,从而造成公司经营业绩波动的风险。

四、重大违规事项

2023年度,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年度,公司主要会计数据如下:

单位:万元

主要会计数据	2023年度	2022年度	增减变动(%)
营业收入	103,741.60	76,750.32	35.17
归属于上市公司股东的净利润	-1,953.08	-2,942.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,652.43	-7,060.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-26,327.05	-11,085.67	不适用
主要会计数据	2023年末	2022年末	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净资产	236,902.53	36,245.64	553.60
总资产	314,490.32	131,675.03	138.84

2023 年度，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2023 年度	2022 年度	增减幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.05	-0.08	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.05	-0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.18	-0.19	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-2.23	-7.80	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-7.60	-18.72	不适用
研发投入占营业收入的比例 (%)	30.28	34.39	减少 4.11 个百分点

2023 年度，公司实现营业收入 103,741.60 万元，同比增长 35.17%，主要系公司继续积极响应客户需求，丰富产品矩阵，做好客户服务，产品应用进一步扩大，随着客户认可度的不断提升，公司与主要客户的合作继续加深，实现业绩持续增长。

2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-1,953.08 万元，同比亏损减少 988.99 万元，仍处于亏损状态。公司亏损收窄主要系在销售业绩持续增长的同时，期间费用率同比下降。期间费用中，财务费用金额同比下降，主要系 2023 年公司为减少汇率波动带来的损失积极调整了外币借款策略，并且汇率波动放缓使得公司 2023 年财务费用同比有所下降。

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-26,327.05 万元，净流出同比增加 15,241.37 万元，主要系为应对销售需求的增长以及下游客户对公司长期稳定供应的需求，公司提升了库存规模并加大了对供应商的产能预定，从而大幅提升了当期向供应商支付的产品采购款及预付款。

六、核心竞争力的变化情况

2023 年度，公司继续保持高强度的研发投入，进一步加强在以太网交换芯片领域的技术积累。同时，公司产品矩阵得以进一步完善，本持续督导期内公司面向大规模数据中心和云服务的芯片产品已经按计划在年底前给客户送样测试。2023 年度，公司的销售收入保持了高速增长态势，2023 年公司实现营业收入 103,741.60 万元，同比增长 35.17%。随着收入规模增长，公司市场地位亦进一步提升，同时在国内以

以太网交换芯片行业，公司仍然保持较强的先发优势，具体分析如下：

1、领先的核心技术优势

全互联时代对以太网交换芯片提出了全面需求，要求芯片实现更快、更灵活、更安全、更智能的网络连接。公司深耕网络技术多年，对网络需求具备深刻理解能力、准确的趋势判断能力，始终坚持以太网交换芯片不仅是简单的高速连接，产品的高性能、灵活性、高安全、可视化更符合全互联时代的网络业务诉求，公司核心价值将进一步放大，持续保持核心竞争力。

在公司产品与同行业主要企业同期推出的同档位产品竞争中，公司产品具备高性能、灵活性、高安全、可视化的技术优势。在端口速率方面，公司芯片产品相较竞品支持更多端口速率。在特性设计上，依托于公司的核心技术积累、对市场需求的充分理解和对趋势的良好判断，针对企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络关键需求进行大量优化，公司在 FlexE、可编程隧道、OAM/APS 引擎等特性方面具备领先性。

在高端产品方面，公司面向大规模数据中心和云服务需求，最大端口速率达到 800G、交换容量为 12.8Tbps 及 25.6Tbps 的高端旗舰芯片已向客户送样，交换容量和端口速率等性能将达到国际竞品水平；规模量产的产品中 TsingMa.MX 产品具备 2.4Tbps 转发能力，支持国内运营商面向新一代通信技术提出的 FlexE 切片网络技术和 G-SRv6 技术。

在产业生态方面，公司积极参与行业标准建设和网络生态组织。公司积极组织参与新一代通信技术、边缘计算和下一代网络和数据中心的标准化工作，参与起草制定行业规范标准、技术白皮书，公司为国内首个开放虚拟化联盟（OVA）成员，亦为 OCP（Open Compute Project）、国内开放数据中心委员会（ODCC）以及中国通信标准化协会（CCSA）的网络组成员。

2、公司在国内具备先发优势

基于以太网交换芯片长期的技术积累和基础行业特征，要成功研发并量产应用具备竞争力的以太网交换芯片至少需要 2-3 代产品、5-7 年的过程。公司自 2005 年设立即开始自主研发以太网交换芯片的历程，为国内最早投入以太网交换芯片研发

的厂商之一。通过大量的研发投入，现已成功开发丰富的以太网交换芯片产品序列、积累领先的核心技术、具备完善的产业链配套、拥有充足人才储备，在国内以太网交换芯片领域具备先发优势。

以太网交换芯片具备客户和应用壁垒，具有平台型和长生命周期的特点。公司产品和技术经过多轮技术迭代和反复终端验证，现已在下游产业规模应用。客户在采用公司产品后，全方位匹配大量软硬件开发成本及软硬件工程人员，部署全新营销方案。考虑到产品对于网络设备整体性能的重大影响以及已有产品的巨大投入，客户极为重视供应商结构的稳定性，使得客户对芯片新进入者接纳性较弱。公司产品在产业链中具备较强的客户粘性，产品生命周期长达 8-10 年。客户往往在产品生命周期中对产品进行长期投资、持续采购并与公司协作开发，不断提升产品渗透率，与公司建立长期稳定的合作伙伴关系。对于其他行业新进入企业，客户在全产业链中更换供应商的意愿较低，更换的时间成本、资金成本与风险较高，新进入企业较难在短时间内克服公司的先发优势。

3、客户资源优势

公司在发展初期就尤其注重客户服务并关注客户体验，通过持续在技术研发、质量管控等方面的投入，为客户提供具有竞争力的产品以及快速响应的优质服务，与国内主流通信和信息技术厂商等建立了长期、稳定的合作伙伴关系，为公司的持续、较快发展奠定了坚实的客户基础。

凭借高性能、灵活性、高安全、可视化的产品优势，公司自主研发的以太网交换芯片已进入国内主流网络设备商的供应链，以公司芯片为核心生产的以太网交换设备已在国内主要运营商以及金融、政府、交通、能源等各大行业网络实现规模应用。进入下游客户供应链后，公司严格筛选经销商，严格把关服务质量，始终在倾听客户的第一线，并通过快速响应的能力、稳定的产品交付能力获得客户的一致好评。此外，公司通过整体解决方案和定制化服务，为客户解决特殊场景以太网交换芯片需求，在最终用户群体赢取口碑、培养市场，从而影响网络设备商开发基于公司芯片的产品，构建全产业链竞争力。

4、本土化优势

我国网络设备行业经过长足发展，已经形成了较为完善的产业体系，具备较强的国际竞争力，并涌现出一批具备国际影响力和知名度的网络设备龙头厂商，也为本土以太网交换芯片设计企业提供了重要的竞争优势。

相对于博通、美满、瑞昱等境外竞争对手，公司一方面坚持立足中国，符合芯片供应链国产替代的行业趋势；另一方面，国内在部分新兴网络通信领域与国际技术路线不同，公司更为贴近、了解本土市场，能够深度理解客户需求并快速响应，予以充分的服务支持，以本地化的支持和服务来吸引客户和提高客户粘性，稳步占据供应链的关键位置；此外，公司与本土网络设备商在企业文化、市场理念和售后服务等方面更能相互认同，业务合作通畅、高效，形成了密切且相互依存产业生态链。

5、人才优势

公司建有国家级博士后工作站、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术中心和苏州市工程技术研究中心。经过十余年的发展以及多代芯片的经验积累，公司逐渐培养并成功打造了一支专业过硬、经验丰富的研发团队，为保障公司持续快速发展奠定了人才基础。公司拥有由多名行业内专家组成的核心技术团队，核心技术人员均拥有 15 年以上集成电路设计经验，团队在以太网交换芯片领域有深厚的技术积累和敏锐的市场嗅觉，能前瞻性地把握行业的发展方向并制定公司研发规划。公司研发团队整体较为稳定，积累了丰富的研发经验和较高的技术水平；同时公司注重研发经验的传承，形成了合理的梯队结构，并设立了行之有效的股权和薪酬激励制度，保证了公司研发团队的长远健康发展。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2023 年度，公司持续保持高强度的研发投入。2023 年度，公司研发投入为 31,411.19 万元，较 2022 年度同期增长 19.00%；研发投入总额占营业收入的比例达到 30.28%，较 2022 年度减少 4.11 个百分点。

（二）研发进展

2023 年度，公司新申请知识产权 129 项，其中发明专利 111 项；新增授权知识产权 34 项，其中发明专利 27 项。2023 年度新增知识产权情况具体如下：

项目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	111	27	1,118	428
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	6	6	137	137
其他	12	1	42	27
合计	129	34	1,297	592

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87 元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并于 2023 年 9 月 8 日出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA10B0607）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
2023年9月8日实际到账的募集资金	202,285.00
减：支付的其他发行费用	1,863.42
募集资金净额	200,421.58
加：累计利息收入扣除手续费金额	130.71
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	19,499.93
募投项目支出金额	6,408.39
永久补充流动资金	58,000.00
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理	80,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	36,643.97
2023年12月31日闲置募集资金现金管理余额	80,000.00
募集资金期末余额	116,643.97

截至2023年12月31日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	募集资金余额（万元）	监管类型
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	475479679425	17,176.98	三方监管
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198823600006712	18,951.68	三方监管
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000531635	7.61	三方监管
上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	89040078801400003300	36.81	三方监管
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	10550301040024198	436.68	三方监管
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	72100122000295332	9.78	三方监管
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001014000758026	12.08	三方监管
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	641065559	12.33	三方监管
合计		36,643.97	/

截至2023年12月31日，闲置募集资金用于现金管理尚未到期情况列示如下：

存放机构	产品名称	存款方式	年末余额（万元）
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	2,300.00
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	2,700.00
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行苏州分行单位人民币定	结构性存款	5,000.00

存放机构	产品名称	存款方式	年末余额 (万元)
苏州分行营业部	制型结构性存款		
宁波银行股份有限公司南京 中山北路支行	单位结构性存款 7202303648	结构性存款	10,000.00
中信银行股份有限公司苏州 金鸡湖支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01044 期	结构性存款	20,000.00
中国民生银行股份有限公司 苏州分行营业部	聚盈利率-挂钩中债 10 年期国债到期收 益率结构性存款	结构性存款	20,000.00
中国农业银行股份有限公司 苏州工业园区支行	/	定期存款	20,000.00
合计			80,000.00

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无控股股东、实际控制人，第一大股东为中国振华电子集团有限公司及其一致行动人中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司。公司上述主要股东的持股情况如下：

序号	名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	中国振华电子集团有限公司	8,717.23	21.26
2	中国电子信息产业集团有限公司	3,039.97	7.41
3	中电金投控股有限公司	604.69	1.47
合计		12,361.89	30.15

截至 2023 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事和高级管理人员（不含通过资产管理计划参与首次公开发行并在科创板上市战略配售获配的股份）的持股情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量 (万股)	间接持股数量 (万股)
1	吕宝利	董事长	-	-
2	SUN JIANYONG (孙剑勇)	董事、总经理、核心技术 人员	-	1,059.79
3	ZHENG XIAOYANG (郑晓阳)	董事、副总经理、核心技 术人员	-	974.59
4	方鸣	董事	-	-
5	张帅	董事	-	-
6	刘澄伟	董事	-	-
7	谢俊元	独立董事	-	-
8	杨爱义	独立董事	-	-
9	应展宇	独立董事	-	-
10	阮英轶	监事	-	-
11	邹非	监事	-	-
12	胡艳华	监事	-	14.28
13	陈凜	副总经理	-	278.78
14	GU TAO (古陶)	副总经理	-	276.00
15	王宁	副总经理	-	133.57
16	王国华	副总经理、财务总监	-	84.84
17	翟留镜	董事会秘书	-	29.59

截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述主要股东及现任董事、监事和高级管理人员直接持有的上述股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

此外，公司上市前，公司部分高级管理人员通过中金盛科 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金盛科 1 号”）持有公司股份，截至 2023 年 12 月 31 日，中金盛科 1 号持有公司股份数量为 245.31 万股，占公司股份比例为 0.60%。具体如下：

序号	姓名	职务	持有中金盛科1号份额的比例
1	SUN JIANYONG (孙剑勇)	董事、总经理、核心技术人员	1.43%
2	ZHENG XIAOYANG (郑晓阳)	董事、副总经理、核心技术人员	1.91%
3	陈凜	副总经理	4.78%
4	王宁	副总经理	4.78%
5	王国华	副总经理、财务总监	4.78%
6	翟留镜	董事会秘书	2.87%

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

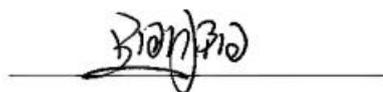
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州盛科通信股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



孔亚迪



吴明阳

